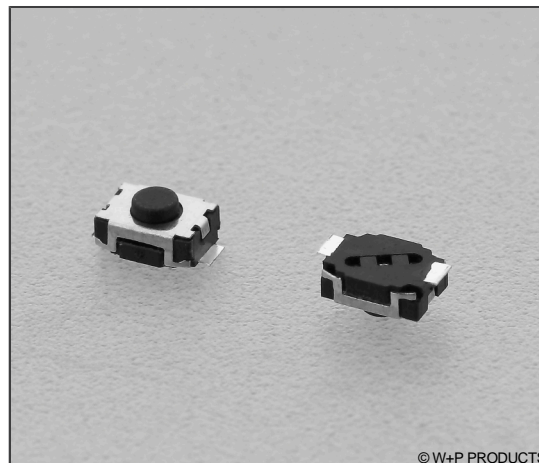


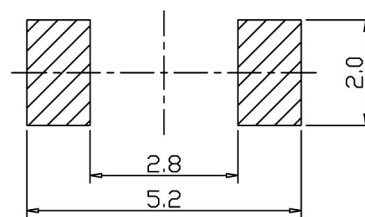
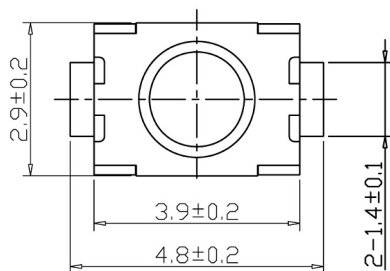
SMT-Mini-Taster, 4x3mm, liegend, Bauhöhe 2,0mm SMT Mini Tactile Switches, 4x3mm, horizontal, 2.0mm Profile

Technische Daten / Technical Data

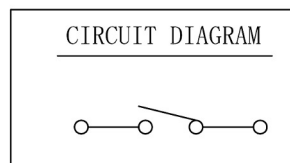
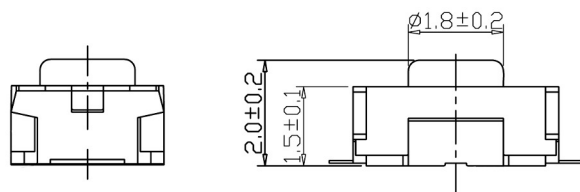
Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplast/Stahl/Thermoplast, UL94 HB
Case/Cover/Actuator	Thermoplastic/Steel/Thermoplastic, UL94 HB
Kontaktmaterial	Messing
Contact Material	Brass
Kontaktbelastbarkeit	50mA, 12V _{DC}
Contact Rating	50mA, 12V _{DC}
Kontaktoberfläche	Versilbert
Contact Surface	Silver plated
Oberfläche Lötanschluss	Versilbert
Plating Solder Side	Silver plated
Durchgangswiderstand	< 100 mΩ at initial state
Contact Resistance	< 100 mΩ at initial state
Isolationswiderstand	> 100 MΩ im Auslieferungszustand
Insulation Resistance	> 100 MΩ at initial state
Spannungsfestigkeit	250 V AC
Test Voltage	250 V AC
Temperaturbereich	-20 °C ... +70 °C
Temperature Range	-20 °C ... +70 °C
Mechanische Lebensdauer	min. 100 000 Schaltvorgänge (160g)
	min. 50 000 Schaltvorgänge (250g)
Mechanical Life	min. 100 000 operations (160g)
	min. 50 000 operations (250g)
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS



P. C. B. Layout



Series	Height	Force	Packaging*
517	1	40	TR
517 Einfachkontakte Single contacts	1 H=2.00mm	40 250g±50	00 TR

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

- 00 Schüttgut / Bulk goods
- TR Tape & Reel (Option) / Tape & Reel (Option)

Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren

Fast Profile Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich T_L	230°C
Verweildauer oberhalb T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 4,5min

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Soldering Range Temperature T_L	230°C
Duration above T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1.5°C / s
Peak Temperature T_P	260°C max.
Duration Peak Temperature	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 4.5min

